

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【公開番号】特開2007-266420(P2007-266420A)

【公開日】平成19年10月11日(2007.10.11)

【年通号数】公開・登録公報2007-039

【出願番号】特願2006-91171(P2006-91171)

【国際特許分類】

H 01 L 23/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

樹脂から成り、染料、顔料またはフィラーが充填された保護層が設けられたダイシングシートに、複数の半導体装置部が形成された半導体ウェハの裏面に前記保護膜が付着するよう、前記半導体ウェハを貼りあわせ、

前記半導体ウェハおよび前記保護膜をダイシングして前記半導体装置部を互いに分離し、

前記ダイシングシートを透過して前記保護膜にレーザー光線を照射することにより、前記保護膜に認識マークを形成し、

分離された前記半導体装置部の裏面に前記保護膜に設けられた認識マークが残る様に、前記ダイシングシートから前記半導体装置部を剥離させる事を特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】

前記保護膜は、前記ダイシングシートよりも前記光線の吸収率が高いことを特徴とする請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】

前記保護膜は、前記ダイシングシートよりも硬い材料から成ることを特徴とする請求項2記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】

前記顔料を前記保護層に充填して吸収効率を高め、更に前記フィラーを充填して前記硬度を高めた請求項3に記載の半導体装置の製造方法。